



# 电子行业周报：21Q4 全球视角： 供不应求的芯片与超预期的资 本开支



通过梳理目前已发布财报的 2021Q4 全球半导体公司财报，从订单、收入、库存以及价格等因素判断，本轮全球半导体景气的持续性有望进一步超预期。设备环节限制在于供应链紧缺，硅片紧缺在于供需格局，累计订单较为充沛。中游制造普遍指引 2022Q1 进一步涨价，且 2022 年全球主要代工厂资本开支增速高达 42%，因此 WFE 有望超预期。下游如汽车、工业芯片将继续紧张，全球前五大汽车芯片厂商均表示 2022 年供不应求的格局将持续存在。

全球核心设备龙头订单整体强劲，短期收入受限于供应链制约，预计 2022 年 WFE 增长约 10~20%。其中，(1) ASML 在 2021Q4 新增订单 71 亿欧元，BB 值 2.0，累计订单充沛，ASML 指引 2022Q1 收入仅为 33~35 亿欧元，预计有 20 亿欧元无法在 2022Q1 确认收入；预计 2022 年增长 20%。(2) LamResearch 预计 2022Q1 同比大幅增长、环比下滑，主要受限于零部件和运输因素；预计 2022 年全球 WFE 增长至 1000 亿美元，增速 18%。(3) TEL 预计 2022Q1 营收同比增长 16%、环比增长 1%。(4) KLAC 预计 2022Q1 营收 22 亿美元，环比下降 9%，下降主要由于供应链限制，积压订单依然强劲。(5) 测试设备龙头存在分化，Teradyne 由于大客户技术周期预计 2022H1 营收同比下滑 15~20%；Advantest 季度新增订单 1363 亿日元，BB 值 1.2，预计 2022Q1 营收同比增长 21%。

全球晶圆厂 2022Q1 毛利率指引普遍环比提升（产品组合与均价上行均有贡献），行业仍有涨价趋势。台积电预测 2022 年全球半导体（不含存

储)增速为 9%,代工市场增长 20%,台积电增长 24~26%。格芯预测 2022 年公司晶圆出货量同比增长 7~9%,ASP 同比增长 10%。联电预测 2022Q1 公司晶圆出货量持平,ASP 环比提升 5%。中芯国际、华虹半导体、世界先进分别预测其 2022Q1 毛利率环比提升 2%、1.8%、0.4%。本轮扩产高峰有望超预期,根据统计,2022 年全球主要代工厂 capex 增速高达 42%!

我们梳理全球前五大汽车芯片厂,2022 年汽车及工业芯片仍将持续供不应求,供应链、库存、交期等一系列问题持续存在,五大厂商指引 2022Q1 收入环比仅有一家下滑,表明行业仍然十分强劲。(1) 英飞凌判断 2022 年全年汽车芯片持续供不应求,但会在一年内逐步改善。英飞凌积压订单超过 310 亿欧元(公司预计 2022 财年收入 130 亿欧元),且其中 80%需求集中于 12 个月,远超过公司的交付能力。(2) 安森美在 2021Q4 法说会上表示其 2022 年产能已经订满,当前是纯粹是供方市场,交货时间高达 45 周,积压订单非常多。(3) 意法半导体同样表示 2022 年汽车的标准产能(MOSFET、IGBT、MCU)已订满,且渠道没有库存积累,同时上游基板、引线框欠缺影响。紧张局势有望在 2022 年底前逐步改善。

(4) 恩智浦下游汽车、工业等领域在未来 4~5 个季度仍然相当紧缺。渠道库存下降到 1.5 个月,持续低于预期的 2.4~2.5 个月,2022 年年内无法解决该失衡问题。

(5) 瑞萨公司及渠道库存均低于目标水平,且周转天数还在下降。截止 2021Q4,公司累计未完成订单超过 1.2 万亿日元(2021 年全年营收

9944 亿日元), 并且难以在 2022 年全部交付, 主要受限于供应链限制和疫情的不确定性。此外, 德州仪器也表示汽车、工业需求旺盛, 资本开支将在 2022~2025 年上升到新的平台, 每年 35 亿美元。

高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化, 以及消费电子细分赛道龙头: 1) 半导体核心设计: 光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及 IP 等产业机会; 2) 半导体代工、封测及配套服务产业链; 3) VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道; 4) 苹果产业链核心龙头公司。

相关核心标的见尾页投资建议

风险提示: 下游需求不及预期; 中美贸易摩擦。

关键词: 涨价 疫情 芯片 苹果

**预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_37542](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37542)

